This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出顧公表番号

特表平6-503062

第3部門第1区分

(43)公表日 平成6年(1994)4月7日

(51) Int,Cl,*	識別記号	庁内整理番号	FI	
C 0 4 B 41/88	υ	6919-4G		
B 2 2 D 19/14	Α	9266 - 4 E		
B 2 2 F 3/02	М	6977 - 4K		
3/26	Α	6977-4K		
B 2 4 B 37/04	Α	7908-3C	•	
		審查請求	未請求 予備	審査請求 有 (全 7 頁) 最終頁に続く
(21) 出顧番号	特膜平4-501994		(71)出顧人	ユナイテッド テクノロジーズ コーポレ
(86) (22)出版日	平成3年(1991)12月	4 ⊞		イション
(85) 翻訳文提出日	平成5年(1993)6月	4日		アメリカ合衆国, コネチカット 06101,
(86)国際出願番号	PCT/US91/	09136		ハートフォード, ユナイテッド テクノロ
(87)国際公開番号	WO92/1044	1		ジーズ ピルディング (番地なし)
(87)国際公開日	平成4年(1992)6月	25日	(72)発明者	ハルパート、ピンク
(31)優先権主張番号	624, 786			アメリカ合衆国, フロリダ 33417, ウエ
(32)優先日	1990年12月4日		1	スト パーム ピーチ ウィロウ ポンド
(33)優先權主張国	米国 (US)		1	コート イースト 4523
(31)優先権主張番号	624, 787		(72)発明者	オウコンネル、トーマス
(32)優先日	1990年12月4日			アメリカ合衆国, ネヴァダ 89014, ヘン
(33)優先権主張国	米国 (US)			ダーソン, サマーズピー ウェイ 1832
			(74)代理人	弁理士 志賀 富士弥 (外1名)
				最終頁に続く
			1	

(54)【発明の名称】 複合一体構造型ラップ盤及びその製造方法

(57) 【要約】

複合一体機造型材料除去磨減ラップ盤は、セラミックまたは金属材料の多孔性焼結マトリクスと、少なくとも、上記ラップにより加工される工作品に接触する上記ラップ盤の有効領域全体において、上記多孔性焼結マトリクスプレフォームの小孔を実質的に完全に充填する多量の含没材料とを含む。上記ラップ盤は、まずスリップ注型によりプレフォームを形成し、次にこのプレフォームを凍結及び凍結乾燥し、さらに乾燥プレフォームを軽く焼結して多孔性マトリクスプレフォームとなし、上記プレフォームの温度を上記含浸材料が流動可能な温度より高くし、上記小孔を上記含浸材料で充填することにより製造される。



請求の範囲

1. 復合一体構造型材料除去磨減ラップ値の製造方法において、 全型キャビディに、セラミックまたは金属粒子を放状媒体と混合 してなる機能スリップを充填して、一次プレフォームを形成する工程と、

上記一次プレフォームを流移する工程と、

上記一次プレフォームを康結乾燥して彼状媒体を取り除く工程と、 このようにして得られた乾燥プレフォームを、より大変の粒子が 融合しそれらの間に相互維結された小孔を残す程度に築結する工程 と、

このようにして得られた多孔性マトリクスプレフォームを、多量の合理材料に、上記含美材料が洗動可能な温度において接触させ、少なくとも、上記ラップ盤により加工される工作品に接触する上記ラップ盤の有効領域の上記小孔を実質的に完全に充填するのに必要な程度に、上記洗動可能な含是材料を、上記多孔性マトリクスプレフォームの上記小孔に侵入させることにより、上記多孔性マトリクスプレフォームを上記ラップ盤に転換する工程とを含むことを特徴とする複合一体構造型材料散去磨滅ラップ鍵の製造方法。

2. 上記会後材料はシリコンであり、上記転換工程は、上記接触 工程の実行前に上記多孔性マトリクスの重度をシリコンの融点より も高級に上げる工程を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。

程は、上記接触工程の実行前に上記多孔性マトリクスの温度をシリコンの融点よりも高温に上げる工程を含むことを特徴とする請求項 4に記載のラップ盤。

- 6. 上記含提材料は、上記ラップ盤の動作量度において最軟な機関のものであり、上記方法は、さらに、上記ラップ盤の育効領域において上記含提材料に研磨粒子を埋め込む工程を含み、この工程は上記有効領域と上記研磨粒子とを相互に押しつける工程を含むことを特徴とする請求項4に記載のラップ盤。
 - 7. 複合一体構造型材料除去磨滅ラップ盤において、

セラミックまたは金属材料からなる多孔性焼結マトリクスと、 少なくとも、上記ラップ盤により加工される工作品に接触する上 記ラップ盤の有効領域全体において、上記多孔性鏡結マトリクスプ レフォームの小孔を実質的に完全に充填する多量の固化合機材料と からなることを特徴とする複合一体構造型材料除去磨破ラップ盤。

- 8. 上記合長材料はシリコンであることを特徴とする領水項 7 に 記載のラップ盤。
- 9. 上記合後材料は、上記ラップ盤の動作機度において柔軟な種類のものであり、さらに、上記ラップの上記有効領域において上記合後材料内に埋め込まれる研磨粒子の層を有することを特徴とする 建京項では記載のラップ盤。



- 3. 上記合長材料は、上記ラップ館の動作機度において最软な程 間のものであり、さらに、上記ラップ盤の有効領域において上記合 長材料に研磨粒子を堪め込む工程を含み、この工程は、上記有効領域と上記研磨粒子とを相互に押しつける工程を含むことを特徴とする始ま項1に記載の方法。
- 4. 全型キャピティに、セラミックまたは金属位子を放伏媒体と 混合してなる機能スリップを充填して、一次プレフォームを形成す る工程と、

上記一次プレフォームを連結する工程と、

上記一次プレフォームを連詰乾燥して被状態体を取り除く工程と、 このようにして得られた乾燥プレフォームを、より大型の粒子が 数合しそれらの間に相互連結された小孔を残す程度に鈍絶する工程

このようにして得られた多孔性マトリクスプレフォームを、多量の含摂材料に、上記含浸材料が被助可能な程度において接触させ、少なくとも、上記ラップ盤により加工される工作品に接触する上記ラップ盤の有効領域の上記小孔を実質的に完全に充填するのに必要な程度に、上記含浸材料を、上記多孔性マトリクスプレフォームの上記小孔に侵入させることにより、上記多孔性マトリクスプレフォームを上記ラップ盤に転換する工程とを含む製造方法により製造されることを特徴とする複合一体構造型材料除去磨減ラップ盤。

5. 上記含浸材料はシリコンであり、上記製造方法の上記転換工

明 和 書

複合一体構造型ラップ盤及びその製造方法

技術分野

本発明は、セラミック物品の製造に関し、特に、研削及び/また は研磨用ラップ盤、ならびに同様な工具の製造に関する。

背景技術

従来、研覧及び/または研磨用のラップ盤として、きまで構成のものが知られており、その中には、鏡、レンズ、その他の光学都品にこのような加工を施すのに特に適したものがある。この種の都品は比較的これれですく、また、表面品質及び形状遺合性のいずれにおいても、できるだけ高い特度が要求される。こに大きくもの、なうなラップ盤は、工作品からの材料除去プロセスに大きく影響するとともに、それで和用途になりに選択されるべき、いつかの特性を有していなければならない。これらの特性を可いていなければない。これらの特性を可いていなければない。これらの特性を可いていていて、工作品がないまたは研磨などの関性は、デップが登または同様な研究とないまたは野野などのできている場合にしたがって、工作品に形成されるのの関性は、材料除去動作中に、は特に顕著となる。ちらに、工具の関性は、材料除去動作中にで、ないと、材料除去動作に、工具の関性は、材料除去動作中にでは特に顕著となる。ちらに、工具の関性は、材料除去動作でなわる形状動物にも影響する。すなわち、魔性のより大きいラップ



特表平6-503062 (3)

個は、より柔軟なタップ強よりも形状制御の点ですぐれている。別の重要な特性は、工具の熱伝導中であり、これは工作品の表面選及 に影響する。そして、工作品の表面選及は形状制御に影響し、さら に材料除去プロセスの化学作用にまで影響することもある。さらに 別の重要な特性は、ラップ盤や同様な工具の硬度であり、これは、 研測セチがどの程度工具に付着するかを決定するものである。

一体構造型ラップ盤の特定の用途における研討や研磨要件のすべ てを満足することは、不可能ではないまでも難しいことが、経験的 にわかっている。その理由は、特に、これらの要件の少なくともい くっかは、耳いに相反するものであるということである。 すなわち、 特性の1つを変化させて上記要件の1つもより満足させようとすれ ば、別の要件の満足度に悪影響をもたらすことになるのが普通であ る。そこで、従来、一体構造型ラップ盤や同様な工具の材料選択は、 しばしば妥協の問題であった。すなわち、さまざまな要件の領対的 な重要度をはかり、最良の(しかし理想のではない)性能が得られ るように工具材料を選択していた。このような妥協の特果、適常、 光学部品の研制や研磨に用いられるラップ盤材料は、ピッチなどの 比較的軟質の材料に所望の研磨剤を含ませたものであり、たとえば、 教養材料体と工作品のあいだに研磨剤の層を介在させ工作品に対し てラップ盤の軟質材料体を押しつけることにより得られる。多くの 場合、軟質材料体を、開性の大きい支持部や背受部に搭載すること により、全体的な関性を増加させている。しかしながら、このよう な方策を禁じても、工作品に最も近接した領域においてラップ体材 料は比較的高い時伏皮を呈するため、工作品の形状ならびに工作品

への研磨粒子の侵入底に悪影響を及ぼすことを防ぐことはできない。 また、研削用ラップ値に研彫粒子が理め込まれていないまたは埋め込まれることにならない、いわゆる自由研磨剤研測を用いることも従来機需されている。ここでは、異なる材料の複数値のラップ盤を用いて、所望の全体的な成果を遊成しようとしている。すなわち、自由研削動作の異なる段階において及び/または異なるの。立とながら、上記複数値の異なるラップ盤を製造または最入し、保管を必要がある。上記複数値の異なるラップ盤を製造または最入し、保管を通切に退択して配便し、免に使用したラップ盤を新しいものと交換する必要が生じるなど、不便なものであった。通常、光学師品の自由研磨剤研削に用いられるラップの関では、種々の開性度を呈する種々のガラス、セラミックタイル、金銭などの、比較的硬質の材料が退れていた。いくつかの例では、確質材料体を、開性の大きい支機の影響を発展に搭載することにより、全体的な関性を増加させていた。

また、スリップ注意により耐熱物質及び金属の形材を成形することが知られている。たとえば、1982年7月27日に付与された米国特許第4、341、725号に、スリップ注型プロセスが関示されている。ここでは、成形工程及びそれに続く成形プレフォームの液結工程に先立って、値刻がスリップに認知され、成形プレフォームの液結中に成形プレフォーム内に生成される水結晶の大きさを十分低いレベルに保ち、プレフォームに対する構造的損傷を防いでいる。このような権係は、水結晶が大きすぎるときに生じる。とこ

ろで、上記特許において、その方法の用途として説明されているのは、一定の内径及び外径をもつ単純な管を製造するという唯一の用途だけである。また、たとえ上記特許が、同じプロセスを用いることによりその他の部品をも製造できると述べているとしても、上記特許に関示されているプロセスにより得られる娩時された最終製品は、その形状にかかわらず、光学部品などの高精度の用途に用いられる自由研磨剤研削工具として用いるには全く不向きである。これは、ひとえに、光学部品などがかなりのもろさを有しているためである。

最後に、本件と同一譲受人に譲渡された米国特許第4、974、225号には、まず多孔性の規能体すなわちプレフォームを形成し、次に、元来流動性をもつ物質をこのプレフォームの小孔に導入し、この小孔を完全に完集してその内部で固化させることにより、固体基板を製造する方法が関示されている。しかしなから、上配特許には、この方法の唯一の用途として、観器板の製造に用いることが関示されているにすぎない。そして、この方法を他の物品、特に研討及び/または研修用ラップ値を製造するのに用い得ることまたは用いるべきであることは全く示唆されていない。

したかって、本発明の包括的な目的は、従来技術の欠点を解消することである。

群しくは、本発明の目的は、従来方法の欠陥を取り除き、自由研 磨剤または埋め込み研磨剤ラップ盤などの、比較的緊固な研制研磨 工具の製造方法を提供することである。

本発明の刻の目的は、製造される工具に求められる要件の換足度

も向上させることができるように改良した上記方法を提供すること である。

本発明のさらに別の目的は、局部的にも全体的にも十分な関性を もち、比較的高速の材料除去速度において、工具により加工される 工作品の形状制御を良好に変現できるようにした研削研磨工具を製 油することのできる上記方法を提供することである。

本発明の付額的な目的は、広範囲にわたる動作条件において、従 来工具に比して、求められる要件をより満足させることのできる特 性を有する、汎用性のある研削研密工具を提供することである。

発明の関示

これらの目的及び以下に明らかになるその他の目的を達成の材料 は、本発明の特徴とするところは、複合的にして一体構造型の材料 除去ラップ盤において、セラミックまたは金属物質からな多多孔性 教師マトリクスと、少なくとも上記ラップ盤により加工されれ孔性 品に控触する上記ラップ盤の有効領域全体において、上記多名を工作 はマトリクスプレフォームの小孔を実質的に完全に充填するを発動 を受けている。本発明の別の類様におりを登して た記ラップ盤は、まず、金型キャビスリップのであまたは 上記ラップ盤は、まず、金型キャビスリップのである。 上記ラップ盤は、まず、金型キャビスリップのである。 上記・次では、まず、金型キャビスリップレフェームを と、上記・次プレフォームを凌結乾後して放状媒体を取り除く と、上記・次プレフォームを凌結乾後して放状媒体を取り除く と、このようにして得られた乾燥プレフォームを、より大型のなる か融合しそれらの間に相互連結された小孔を養す程度に続結する



限と、このようにして得られたマトリクスプレフォームを上記合長 物質の融点よりも高温にし、上記多孔性マトリクスプレフォームを 上記多量の総融合長物質に接触させ、少なくとも、上記ラップ器に より加工される工作品に接触する上記ラップの育効領域の上記小孔 を質質的に完全に充填するのに必要な程度に、上記溶融合長物質を、 上記マトリクスプレフォームの小孔に侵入させることにより、上記 多孔性マトリクスプレフォームを上記ラップ銀に伝換する工程によ

西面の簡単な説明

本発明は、最付限面を参照してより詳細に説明される。条付図面において、

第1回は、本発明による研削研修用ラップ集の平面図でありラップの有効領域を示している。

第2回は、ラップ線の一部を示す第1回の2-2線に拾った拡大 新面回であり、ラップ値により加工される工作品の一部と並べて示している。

第3回は、第2回の3-3線に沿った紐部を示すさらなる拡大圏であり、特に、自由研磨剤研削に用いるものとして構成されたラップ艦の有効機械の内部構造を示している。

第4回は、堤め込み研磨剤研削や研磨に用いるものとして構成されたラップ盤の第3回と同様な図である。

発明を実施するための最良の形態

成用の「生状態の」物体を得るプロセスを表わしている。

本発明の方法の実施に用いられるスリップに合有される粉末は、 好ましくは、大型粒子17と小型粒子18とを互いに密に混合した ものである。上述のスリップ性型プロセスにより得られた「生の」 プレフォームは、次に軽く鋭軸される。すなわち、小型粒 溶融して大型粒子17を互いに連結し、比較的安定しているが全く もろい第3回に示した多孔性マトリクスを形成する程度に、気候結す る。ラップ第10用の、このようにして得ら成する程度でレフォーム なわち液状の状態にある孔充填物質すなわち含度物質19または1 9'に接触させ、孔充填物質19または19'を、鏡結粒子17及 び18の間に存在する孔すなわち間膜に侵入させる。これは くとも領域11に浸透する間膜に侵入させる。このようにし て、このプレフォームはラップ盤10に転換される。

スリップ注型プロセス中に、「生の」プレフォームに第13及び 14を設けるようにしてもよい。これは、たとえば、注型用会型に 会型の内部空間にくいこむ突起すなわち突角を設けることにより行 なわれる。また、終13及び14を、より後の設備で、たとえば、 焼詰後またはそれ以降に、フライス加工などの材料除去工程により、 形成することもできる。焼結プレフォームをラップ盤10へ転換し たのち、領域11を加工してメサ15から材料を除き、露出面16 を形成する。これは、主として、ラップ盤10の露出面18の 状などの所望の形状を与えるため、また、メサ15の露出面18の

特表平6-503062 (4)

まて、図面を拝卸に参照すると、符号10は、本発明の研訓研修用ラップ館の全体を示している。ラップ館10は、円形ディスクの形状を育するものとして図示されている。第1回及び第2回の比較から明らかになるとおり、図示のラップ館10において、第1回の観察者に対面する露出主面12の領域11には、ほぼ季間隔の歳13及び14との2つの直交する列が設けられ、これらは互いに交接し、舞出主面12の下方の、領域11の最きに対応する、ある最終まで字段されている。これにより、領域11は、ほぼ正方形の輸絡をもつ多数の酸起節すなわちメサ15に分割されている。特に第2回に示されるように、満13及び14は、舞出主面12を、メサ15の各貫出面18に分割し、これらは、ラップ館10が使用位質にあるときに研究研修される工作品20に対面する。

以上、図示した形状のラップ盤10について説明したが、以下、 その内部構造及びこの内部構造を得るための好ましい方法について、 第3回及び第4回を参照してまず概略的に説明する。当初は、自由 研磨初研制用と埋め込み研磨和研削用のラップ盤の構造を区別せず に説明することとする。

第1のステップとして、ラップ盤10の「生の」プレフォームが スリップ注型により製造される。この例は、上記2件の米国特許に 関示されており、このスリップ注型プロセスの存舗についてはこれ らを参照されたい。「スリップ注型」なる表現は、ここでは、金属 粉末、セラミック粉末、炭素粉末、またはこれらの粉末の配合物と、 液体(通常は水)からなる注入可能なスリップを、非級収性の型に 注入し、混合物を液結し、型から取り出して最後に液筋乾燥し、焼

表面品質を改良するために行なわれる。

合長物質19及び19、の主な相違点は、物質19は、統結プレフォームの小孔に導入後比較的硬くなるのに対し、物質19、は、ラップ盤10の使用中にラップ盤10の領域11において生じるすべての機度においてマトリクス材料に比べて教質すなわち柔軟であることである。

<u> 94 1</u>

第3図に示す種類のシリコンカーバイド自由研磨剤ラップ盤は、 次のようにして構成される。

以下の材料を以下に示す量ずつ混合し、約27時間にわたってジャー型ミルにおいて圧延することにより、1回分の住理用スリップを 類似した。

シリコンカーバイド設束(P-320) 5.773.8g シリコンカーバイド設束 (~1.0μm) 4.220.0g 水 1.313.7g ケイ酸ナトリウム 34.8g

このようにして顕製された注型用スリップは、供給ロを介して多 電部品組立式全型キャビティに導入され、これにより押しのけられ た空気は、説出ロを介して全型キャビティから放出された。充填中 及びその後15分間にわたって全型及びスリップを振動させ、是入 学気を添かした。

依然組立状態の全型とその内容物は、-85℃に保たれた冷凍室



に置かれ、約30分間放置される。次いで、金型とその内容物を冷 液理場から取り出し、金型部分を分解して凍結した「生の」プレフォ ームを取り出す。液結プレフォームは次に~85℃で約1時間にわ

たり平衡状態に優たれた。

その後、液筋等達品は、以下のステップにおいて、最終製品に転換される。まず、雪温で約100μm日度に排気された変に置かれる。真空排気は約16時間続けられ、真空レベルが50μm日度を越えたことが観察された。これは、乾燥液筋(界準)プロセスが実質的に完務し、海流品は乾燥されたものと考えられることを示している。乾燥した等造品は、ある分圧のアルゴン雰囲気において、2050での温度に置くことにより、軽く鏡符された。

内に)、メザ領域を上にしてアルミ製ヒートシンク底板の上向き面上に配置し、溶験ビッチを注いでプレフォームの頂部領域全体にれたがらせ、旋結マトリクスの小孔内に流れ込ませた。周面に配むされたアルミテープまたはホイル、もしくは、ヒートシンク底板のいずれかにたどりついたビッチは、接触するやいなや液結すなわら固化されて各小孔を書ぐため、ビッチの外部洗出が避けられ、ビッチが固化して表面ことはない。最後に、このように心切され、腰りのビッチが固化して裸造1g′が得られた。そして、プレフォームを底板から取り外し、周囲テープやホイルをはがす。このようにして、以降の機械工作やその他上述した種類の加工に用いられるプレフォームが製造される。

<u>64.3</u>

例2の工程は、シリコンカーバイド/鉛複合ラップ銀の製造においても用いられる。ただし、焼精プレフォームの温度は、移動鉛をプレフォームの頂面上に注いで広がらせる前に、鉛の熔散温度を超える温度まで(約3 7 5 でまで)上げられる(予熱など)。

第2回及び第3回を比較して、研削加工が例1のラップ盤10を 用いて実行される場合には、ラップ盤10の領域11は、実際の研 耐加工中に、グリットすなわち研修位子21の層22に接触する。 この研磨粒子21は、単独でまたは冷却媒体やペーストなどの機能 媒体との混合または懸層状態で、加工する工作品20の表面上に載 せられる。ラップ盤10により研修位子21を含むまたは研磨粒子 特表平6-503062 (5)

リコンが侵入するように、避択及び/または制御される。この程度 に侵入すれば、ラップ量は、その大半の用途において、十分な機能 を呈たす。

場合によっては、シリコンに接触させる値段に、シリコンの搭載 温度に近い温度もしくはそれ以上の温度に、統領プレフォームモ予 熱することが望ましい。このことにより、シリコン粉束の溶散、及 び、それに続く保護雰囲気環境における統領マトリクス内への侵入 に必要な時間を組織できる。いずれにしろ、プレフォーム内へのシ リコンの侵入が充了したあとで、このようにして得られたラップ盤 1 0 は冷却され、統結シリコンカーバイドマトリクス 1 7 及び 1 8 の小孔内のシリコン 1 9 が固化される。その後、メサ 1 5 の表面 1 6 の品質を向上させるために、領域 1 1 を研削して表面 1 6 から材料を除くようにしてもよい。

21.2

第4回に示した種類のシリコンカーバイド/ビッチ複合ラップ盤は、まず、上記の工程をプレフォームの終結プロセスまで含めてたどることにより形成された。次に、この部分的に焼結された多孔性プレフォームの関膜すなわち小孔を、以下に述べるようにして、ビッチで充填した。まず、小孔の充填中にビッチが興団から適けるのを防ぐため、プレフォームの周辺を、アルミホイルまたはテープを貼付することにより被覆した。そして、プレフォームを、ビッチの溶酸温度以上に加熱し(研磨研削加工に適したものとして知られる組成範囲内のビッチの正確な組成に応じて、約95~120℃の範囲

2 1 からなる暦 2 2 上に加えられる圧力は、ラップ銀 1 0 が工作品 2 0 に沿って運動するのに伴い、この研磨粒子 2 1 を移動させる。その結果、研磨粒子 2 1 は、領域 1 1 に対面する工作品の表面から工作品 2 0 の材料を磨破する。ラップ銀 1 0 の使用中に加えられる圧力及び/または研磨粒子 2 1 の大きさは、工作品 2 0 内への研磨粒子 2 1 の使人深さ、ひいては、工作品の表面品質を決定する。

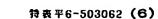
他方、例2及び例3のいずれかのラップ盤10を使用する前に、 領域11に研磨粒子21′を含ませておくことが好ましい。これは、 たとえば、ラップ盤10の領域11を、主面12の形状にほぼ適合 する形状の支持部上に韓置された研磨粒子21′の層に対して、子 め定められた力で押しつけることにより、実現できる。しかしなが ら、このような研磨粒子の含入は、実際の研削研磨加工中にも自動 的に行なわれる。すなわち、このような研磨粒子21の磨22′が、 単独でまたは冷却媒体やペーストなどの撮送媒体との混合または感 歯状態で、加工する工作品20の表面上に形成され、ラップ競10 が着22~に押しつけられる。いずれにしろ、ラップ盤10により 研身粒子21′の層22′などの各層に加えられる圧力により、こ の研磨粒子22.はラップ盤10の領域11内、特に、比較的軟質 の孔充填材料19、内に埋め込まれる。研磨粒子21、がこのよう にして領域11内に埋め込まれた後、ラップ盤10を用いて、ラッ ブ焦10の露出面12に対脑する工作品20の表面を研磨研制する ことができる。すなわち、第4因から理解されるように、堪め込ま れた研密粒子21′により工作品20の材料が磨滅する。ここで再 び、ラップ盤10の使用中に加えられる圧力及び/または研磨粒子

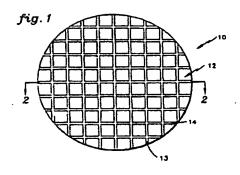


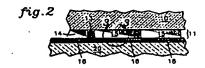
21'の大きさは、堪め込まれた研磨粒子21'の工作品20内への侵入機さ、ひいては、工作品の表質品質を決定し、さらには、研 動加工または研磨加工のどちらかに豊誠動作を分隔する。

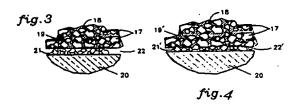
どの場合にも、生成品 1 0 は複合体であって、しかも一体構造型の、比較的関性の高い構造であった。しかしながら、少なくともラップ盤 1 0 のメザ領域 1 1 において、シリコン、タールピッチ、始などの孔充域材料が存在するために、多孔性鏡替プレフォームの元条のもろさの思影響を免れることができるだけでなく、覆々の大きさの研磨粒子 2 1 や 2 1 で を用いることにより、各研訓研磨工程または政際における所望の磨滅度を達成することができる。 きらに、このようにして得られたラップ盤 1 0 は、ラップ盤を構成する 2 つの物質の優れた特性のほとんど環想的な組み合わせを提供する。すなわち、シリコンカーバイドの高い開性と高い熱伝導率により形状刻物が良好となるとともに、各合後材料の柔軟性が高いため、研修粒子 2 1 や 2 1 の取込み度が向上する。その一方で、これらの材料により不利な効果が生じることが回避される。

以上、本発明を、機械研削、研磨、その他国様な材料除去加工に用いるシリコンカーバイド/含提材料複合ラップ盤の特別の構造に適用した場合について説明したが、本発明は、これらの実施例に限定されるものではなく、本発明の範囲は、銀付の請求の範囲によってのみ決定されるものであることは言うまでもない。









30	•	A	壹		-	~~	PCT.	rus	71/	0913
1 0	_	-	-	-	 نوف بد		 -			

				برب مستعد بہترہ صحب		
-		-				
lat.Ci.	S CO4835/5		B24837/04;	C0484 1/50:	α	HB41/47
	CD4841/S	1; (822F3/22;	B22F3/26		
is projekt sa						
C. FRALES C.						
-	Cyronia .			ججما حبحب		
Ems.Cl. !	5	C048 :	824B ;	822F ;	8240	
		1				
			-			
				er before a de Peta Se		
ST POCING		D TO BE RELEVA				
	Character of the		-		···	
						<u> </u>
x	US.A.4	141 725 (G.	D. WEAVER ET	AL.) 27 July 1	982	1.2
- 1	cited by	y the appli	CARE			1
- 1	see cla	n 1; exemp	iles 1.2			1
1		-				1
x į			ELIERS PARTI	OT-CENENTATION)	22	4,6,7,9
. 1	Ray 1959					
^ 1	see clas	tus 1-3; es	zepla 5			, ,
. 1						1
^ {	U3,A,Z	118 (F.	R. MENSEL ET	AL.) 27 Octobe	•	4,6,7,9
1	1942					į.
. 1			WFR44 F1FARA	DE (THA-9803 31		1
	Apr 11 31	110 121 (65	NEWAT FIFTH	TE COMMAND TO		4-9
- 1			- 1fae 23:	classa 1 1		ŀ
		•				İ
4 I	WO.A.9	301 472 (W.	CLAUSSEN) &	2 February 1990		4.5.7.8
1	see clas	ms 1-4.6.1	0.25			1,10,000
						l .
				~/~~		l .
- 1						l .
ı						
						<u> </u>
				T		
	سومت فجنيتها بد					
T ===						
-	_			T =======		
~ ===					-	
-				=:==		***
T ===	:==::		مية جبية وطلك			
						-
. 00000						
-	ر بر سنبت د	-	-	Date in spinish in the	-	- Depart
	CS AP	RIL 1992		,		0.06.92
				į .		. u. u. ac
	-			Control of Street,	-	
	CONT	# FATEST 001	-	HAUCK N.		
-						

	المناهبة المنتهدية	PCT/US	91/09136
W. horse	EP-TH COMMERCIED TO BE BELLEVARY (CONTROLLS FROM THE SECOND ENERT)		
9-71	منسب است. به بدوله بازد ماهم الموسيد به الموسيد به الموسيد الموسيد الموسيد الموسيد الموسيد الموسيد		
		1	
- 1		ı	
E,P	US,A,4 975 825 (A.M. VIVALDI ET AL.) 4 Cocomber	3.2	
	1990	1 ***	
- 1	cited by the employees		
	cited by the applicant see claim 1; examples 1,2		
1			
1		ľ	
- 1		1	
		ı	
		1	
		ı	
		i	
		ı	
		i	
- 1		- 1	
		- 1	
- 1		ł	
ŀ		- 1	
- 1		- 1	
- 1		ı ı	
- 1	•	- 1	
- 1		ı	
1			
		- 1	
1			
- 1			
- 1			
- 1		- 1	
		- 1	
- 1			
i		- 1	
- 1		- 1	
I		1	
- 1			
1		1	
		1	
		- 1	
		ı	
		ı	•
ı		1	
1			
		ì	
		1	
- 1		1	
- 1		1	
1		1	
		1	
		1	
- 1			



.

US 9109135

This came has no passer bandy consistent relating to the private foreign still be the alternational behavioral earth Piperit. The supplement or command to the Company Federal Differ COV The sea. The supplement of the private private private processing which are quarter than the the presence of behavioral to COV/COS FE.

27272	~==-	********		
U3-A-4341725	27-07-62	Tree		
FR-A-1179314		lace		
U3-A-2300118		None		
EP-A-0010257	30-04-60	US-A- 42201 AU-B- 5342 AU-A- 52038 JP-C- 14995 JP-A- 550600 JP-B- 630447	53 12-0 79 01-0 05 29-0 14 06-0	1-84 5-60 5-89 6-80
40-A-9001472	22-02-90	DE-A- 38373	79 09-0	2-90
US-A-4978225	04-12-90	U3-A- \$0357	25 30-0	7-91
w apon death about \$60 pages ;		·		

フロントページの続き

(51) Int. Ci. 5	幾別記号	庁内整理番号	FI
B 2 4 D 3/00	340	7908 - 3C	
CO 4 B 39/00	304	B 7202 - 4G	

(81)指定国EP(AT, BE, CH, DE,
DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, MC, N(72)発明者
アメリカ合衆国、フ
クエコーピー、エス

(72)発明者 ブラット、ロイス アメリカ合衆国、フロリダ 34874、オウ クエコーピー、エスダブリュー 144ス パークウェイ 13854